

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年3月9日(09.03.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/032782 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) C09J 183/05 (2006.01)
B32B 7/12 (2006.01) C09J 183/07 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/031855

(22) 国際出願日: 2022年8月24日(24.08.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-139880 2021年8月30日(30.08.2021) JP

(71) 出願人: 日産化学株式会社(NISSAN CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 奥野 貴久 (OKUNO Takahisa); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 臼井 友輝 (USUI Yuki); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 柳井 昌樹 (YANAI

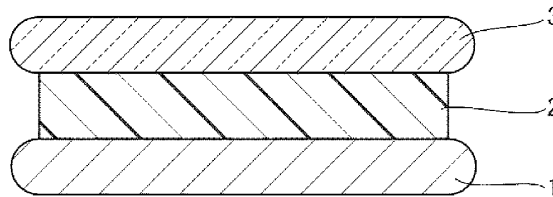
Masaki); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP). 新城 徹也 (SHINJO Tetsuya); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉635 日産化学株式会社材料科学研究所内 Toyama (JP).

(74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (TAKAOKA Ryoichi et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋5-4-7 池袋トーセイビル5階 高岡IP特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION, MULTILAYER BODY, AND METHOD FOR PRODUCING PROCESSED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 接着剤組成物、積層体、及び加工された半導体基板の製造方法



(57) Abstract: A multilayer body which comprises a semiconductor substrate, a supporting substrate and a bonding layer that is provided between the semiconductor substrate and the supporting substrate, wherein: the bonding layer is formed of a cured product of an adhesive composition; the adhesive composition contains a polyorganosiloxane that has an alkenyl group bonded to a silicon atom and having 2 to 40 carbon atoms, a polyorganosiloxane that has an Si-H group, a platinum group metal catalyst and a crosslinking inhibitor; and the crosslinking inhibitor contains at least either a pyridine ring-containing compound or a phosphorus-containing organic compound.

(57) 要約: 半導体基板と、支持基板と、前記半導体基板と前記支持基板との間に設けられた接着層とを有する積層体であって、前記接着層が、接着剤組成物の硬化物から形成され、前記接着剤組成物が、ケイ素原子に結合した炭素数2~40のアルケニル基を有するポリオルガノシロキサンと、Si-H基を有するポリオルガノシロキサンと、白金族金属系触媒と、架橋阻害剤とを含有し、前記架橋阻害剤が、ピリジン環含有化合物、及びリン含有有機化合物の少なくともいずれかを含有する、積層体。

[続葉有]

WO 2023/032782 A1

SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))